

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于 2007 年 6 月 13 日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第八次会议通知，2007 年 6 月 21 日公司第五届董事会第八次会议以传阅方式召开。公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过如下议案：

一、公司拟用部分控股子公司股权进行抵押贷款的议案

本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期授信额度。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75%的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100%的股权。

鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，急需一定额度的流动资金保障，因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度，并用公司部分控股公司的股权进行抵押。

（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：1480 万元美元，其中本公司直接持有其 75%的股权，公司全资控股子公司 BACHFIELD LIMITED 持有其 25%的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备 and 成套技术研发、生产、销售（80%外销、20%内销）。

截止 2006 年 12 月 31 日该公司总资产为 22,914.63 万元，净资产 13,760.93 万元（经审计）

（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资控股孙子公司，注册资本 2000 万元，其中本公司持有其 5%的股权，本公司全资控股子公司长春中科英华科技发

展有限公司持有其 95% 的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

截止 2006 年 12 月 31 日该公司总资产为 23,380.59 万元，净资产 10,555.08 万元（经审计）。

二、上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请的最高限额 4000 万元 1 年期授信额度，并由本公司提供担保。

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资控股子公司（本公司直接持有其 90% 的股份）。该公司是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向招商银行上海分行申请的最高限额 4000 万元 1 年期授信额度，并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司授信额度并由本公司为其担保。

截止 2006 年 12 月 31 日该公司总资产为 18,138.59 万元，净资产为 10,099.11 万元，2006 年度实现主营业务收入 14,111.47 万元，净利润-347.62 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年 6 月 23 日